

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于对外投资半导体封装产业项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》，公司与广州经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签署了《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”）。2019 年 10 月 10 日开发区管委会向公司出具了《关于对延期设立项目公司有关事宜的复函》，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》（公告编号：2019-06-029）、于 2019 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的进展公告》（公告编号：2019-10-048）。根据投资合作协议相关内容及复函要求，公司需在 2019 年 12 月 31 日前在广州市黄埔区、广州开发区内设立具有独立法人资格的芯片封装基板项目公司，负责该项目的具体运作；并由开发区管委会下属机构广州开发区投资促进局（以下简称“投促局”）就该项目的具体事宜与公司对接。现将相关事项进展情况公告如下：

公司已与投资方科学城(广州)投资集团有限公司(以下简称“科学城集团”)、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）就本项目合作条款基本达成一致，科学城集团及大基金正在履行内部审批程序。鉴于项目推进的实际情况，投促局同意协助公司

申请延期设立项目公司，设立期限延至 2020 年 2 月 29 日，最终申请结果以开发区管委会复函为准。

公司将持续关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日